	<b>ใบงานที่ 12</b>	หน่วยที่ 12
	วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น	สอนครั้งที่ 16
	ชื่อหน่วย การบัดกรี	เวลารวม 4 ชั่วโมง
เรื่อง การบัดกรี		เวลา 4 ชั่วโมง

### จุดประสงค์การเรียนรู้

#### จุดประสงค์ทั่วไป

1. เพื่อให้มีทักษะเทคนิคการบัดกรีในงานอิเล็กทรอนิกส์

#### จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

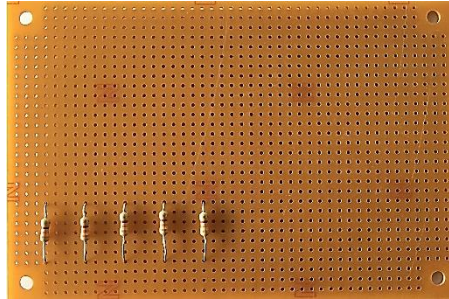
1. เลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการบัดกรีได้
2. บัดกรีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้
3. นำการบัดกรีไปใช้งานได้

### เครื่องมือและอุปกรณ์

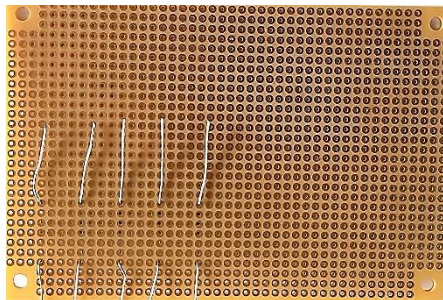
- |   |        |
|---|--------|
| 1. หัวแร้ง                                    | 1 ตัว  |
| 2. คีมตัด                                     | 1 ตัว  |
| 3. คีมจับ                                     | 1 ตัว  |
| 4. ที่ดูดตะกั่ว                               | 1 อัน  |
| 5. ตะกั่ว                                     | 1 ม้วน |
| 6. แผ่นปริ้นเอนกประสงค์ (ไข่ปลา) ขนาด 5×7 CM. | 1 แผ่น |
| 7. Socket IC DIP 16 PIN                       | 2 อัน  |
| 8. ตัวต้านทาน                                 | 10 ตัว |
| 9. ผ้าเช็ดหัวแร้ง                             | 1 ผืน  |

### ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน

1. ให้นักเรียนนำตัวต้านทานจำนวน 5 ตัวใส่ลงปรีนเอนกประสงค์ โดยเว้นระยะห่างเพื่อความเหมาะสม ดังรูปที่ 12.1(ก) และ รูปที่ 12.1(ข) เพื่อบัดกรี

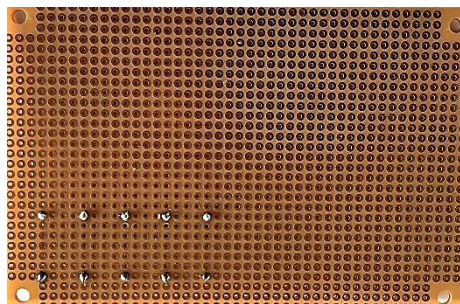


รูปที่ 12.1 (ก) การลงตัวต้านทานด้านบน



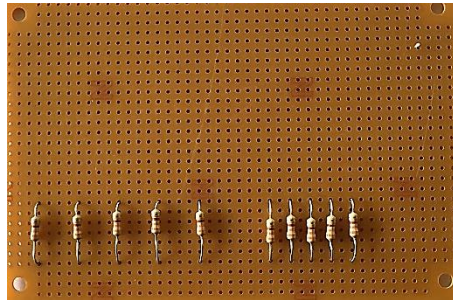
รูปที่ 12.1 (ข) การลงตัวต้านทานด้านล่าง

2. บัดกรีขาตัวต้านทานจำนวน 5 ตัว พร้อมตัดขาด้วยคีมตัดให้เรียบร้อย แสดงดังรูปที่ 12.2

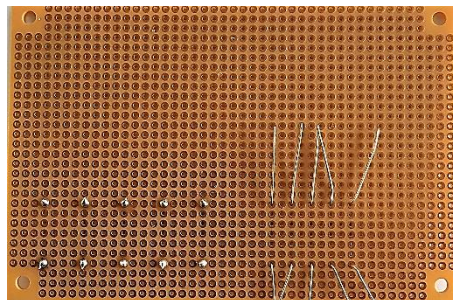


รูปที่ 12.2 การบัดกรีตัวต้านทานและตัดขาตัวต้านทาน

3. ให้นักเรียนใส่ตัวต้านทานจำนวน 5 ตัวที่เหลืกลงแผ่นปรีนเอนกประสงค์แสดงดังรูปที่ 12.3 (ก) และ รูปที่ 12.3 (ข) เพื่อบัดกรี

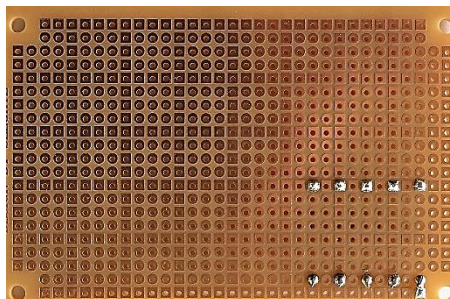


รูปที่ 12.3 (ก) การลงตัวต้านทานด้านบน



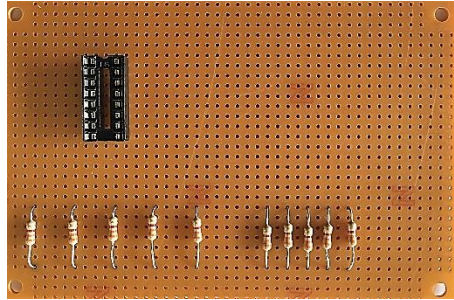
รูปที่ 12.3 (ข) การลงตัวต้านทานด้านล่าง

4. บัดกรีขาตัวต้านทานดังรูปที่ 12.4 พร้อมตัดขาด้วยคีมตัดให้เรียบร้อย แสดงดังรูปที่ 12.4



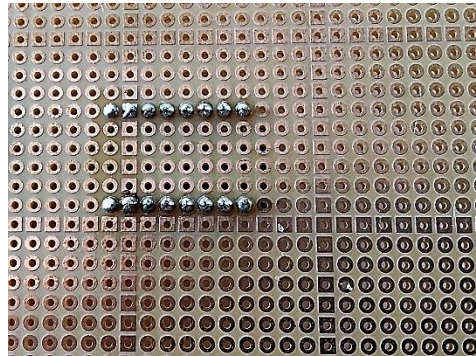
รูปที่ 12.4 การบัดกรีตัวต้านทานด้านล่าง

5. ให้นักเรียนนำ Socket IC DIP 16 PIN ใส่ลงแผ่นปริ้นเอนกประสงค์ แสดงดังรูปที่ 12.5 เพื่อฝึกบัดกรีในระยะใกล้



รูปที่ 12.5 การลง Socket IC DIP 16 PIN

6. บัดกรี Socket IC DIP 16 PIN ให้เรียบร้อย แสดงดัง รูปที่ 12.6



รูปที่ 12.6 การบัดกรี Socket IC DIP 16 PIN

**สรุปผลการทดลอง**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**คำถามท้ายการทดลอง**

1. จงบอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการบัดกรี มาอย่างละเอียด

.....

.....

.....

.....

2. จงบอกการบัดกรีที่ดีอย่างน้อย 5 ข้อ

.....

.....

.....

.....